

广州方邦电子股份有限公司

关于参加 2023 年度科创板半导体材料专场 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：线上文字互动
- 投资者可于 5 月 16 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 and 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）已于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 23 日分别发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度科创板半导体材料专场业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟

通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年5月17日(星期五)下午 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：线上文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理苏陟先生、董事会秘书王作凯先生、独立董事倪丽丽女士。(如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，若发生人员调整，会议召开前将做出相关说明。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月17日(星期五)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会。

(四) 投资者可于2024年5月16日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：020-82512686

邮箱：dm@fbflex.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024年5月11日